

证券代码：301678

证券简称：新恒汇

公告编号：2026-041

新恒汇电子股份有限公司

关于使用超募资金投资建设新项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 1、新建项目名称：蚀刻引线框架生产车间扩建及物联网 eSIM 芯片封测扩产项目
- 2、投资金额及资金来源：本项目计划投资总额 13,000 万元，拟使用公司首次公开发行股票部分超募资金 8,781.65 万元及公司自有资金 4,218.35 万元。
- 3、本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
- 4、风险提示：上述事项尚需提交公司股东会审议。本次使用超募资金投资建设的新项目在实施过程中，如因国家产业政策变化、宏观经济环境变化、市场需求变化等因素，可能出现新项目实施延期、变更、项目效益不达预期或终止等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

新恒汇电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 10 日召开第二届董事会第二十次会议和第二届董事会审计委员会第十九次会议，分别审议通过了《关于使用超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用首次公开发行股票部分超募资金 8,781.65 万元以及公司自有资金 4,218.35 万元，共计 13,000 万元，建设“蚀刻引线框架生产车间扩建及物联网 eSIM 芯片封测扩产”项目（以下简称“新项目”），新建蚀刻引线框架生产车间及配套设施 22,483 m²，为后续提升高密度蚀刻引线框架产能以及产线自动化、智能化水平打下坚实基础；同时购置全自动金丝焊线机、塑封机等物联网 eSIM 芯片封测先进生产检测设备共计 21 台，打通物联网 eSIM 芯片封测产能瓶颈，扩大产能规模，满足公司业务规模增长的需求。

公司董事会、审计委员会对上述事项发表了明确的同意意见，方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了无异议的核查意见，

本事项尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。本次使用超募资金投资建设新项目不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意新恒汇电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕525 号）文件批复同意，公司获准向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 5,988.8867 万股，发行价格为 12.80 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 76,657.75 万元，扣除发行费用 8,461.17 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 68,196.58 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2025 年 6 月 17 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2025]第 ZA14610 号）。公司已根据相关规定将上述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构及存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目具体情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2025-014）披露，本次募集资金投资项目情况如下：

单位：万元		
项目名称	项目总投资金额	拟投入募集资金金额
高密度QFN/DFN封装材料产业化项目	45,597.01	45,597.01
研发中心扩建升级项目	6,266.12	6,266.12
多功能智慧物联仓储中心建设项目	7,551.80	7,551.80
合计	59,414.93	59,414.93

三、本次使用超募资金投资建设新项目的具体情况

（一）项目概述

为提高募集资金的使用效率，进一步提升公司规模和盈利能力，公司本次计划使用超募资金投资建设蚀刻引线框架生产车间扩建及物联网 eSIM 芯片封测扩产项目，本项目实施主体为新恒汇电子股份有限公司，项目建设期为 16 个月。该项目是公司在蚀刻引线框架与物联网 eSIM 芯片封测领域的技术积累与市场基础上，通过新建专业化蚀刻引线框架生产车间、完善配套公用工程体系，改善生产环境，为后续提升高密度蚀刻引线框架产能以及产线自动化、智能化水平打下

坚实基础；同时通过购置物联网 eSIM 芯片封测先进生产检测设备，打通产能瓶颈，扩大 eSIM 芯片封测产能规模，进一步巩固公司在集成电路封装材料与封测细分领域的市场地位，增强核心竞争力与持续盈利能力，促进公司主营业务稳健可持续发展。

（二）项目基本情况

- 1、项目名称：蚀刻引线框架生产车间扩建及物联网 eSIM 芯片封测扩产项目
- 2、项目实施主体：新恒汇电子股份有限公司
- 3、项目实施地点：山东省淄博市高新区中润大道 187 号公司厂区内
- 4、项目建设周期：本项目建设周期为 16 个月，最终以实际开展情况为准
- 5、项目投资资金及来源：本项目计划投资总额 13,000 万元，拟使用首次公开发行股票部分超募资金 8,781.65 万元，使用公司自有资金 4,218.35 万元。
- 6、项目投资构成及主要经济技术指标：

本项目计划总投资额 13,000 万元，其中：蚀刻引线框架生产车间扩建子项目投资 11,500.00 万元，物联网 eSIM 芯片封测扩产子项目投资 1,500.00 万元。

本次蚀刻引线框架生产车间扩建子项目主要建设生产车间，不购置设备，不产生收益，因此本次只考虑物联网 eSIM 芯片封测扩产子项目购置设备投产带来的收益。

物联网 eSIM 芯片封测扩产子项目达产年营业收入 2,200.00 万元，总成本费用 1,362.25 万元，上缴税金总额 268.99 万元，净利润 568.76 万元。具体如下：

图表1 项目主要经济技术指标表

序号	项目	单位	指标	备注
一	建设规模及内容			
(一)	蚀刻引线框架生产车间扩建子项目			地上 3 层，地下局部 1 层
1	生产车间及配套设施	m²	22,483	地上 3 层，地下局部 1 层
(二)	物联网 eSIM 芯片封测扩产子项目			
1	全自动金丝焊线机等设备	台	21	
二	项目总投资	万元	13,000.00	
1	蚀刻引线框架生产车间扩建子项目	万元	11,500.00	88.46%
2	物联网 eSIM 芯片封测扩产子项目	万元	1,500.00	11.54%
三	资金筹集	万元	13,000.00	
1	募集资金	万元	8,781.65	67.55%
2	自筹资金	万元	4,218.35	32.45%
四	主要财务指标			
1	营业收入	万元	2,200.00	达产年

2	利润总额	万元	669.13	达产年
3	净利润	万元	568.76	达产年
4	税前投资财务内部收益率		33.37%	所得税前
5	税前静态投资回收期（不含建设期）	年	2.78	所得税前
6	税后静态投资回收期（不含建设期）	年	2.88	所得税后
7	盈亏平衡点		22.00%	生产能力利用率

7、本项目已经完成投资项目备案程序，环评、安评、规划等相关程序正在进行，公司将根据规定和要求履行相关程序。

8、本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

（三）项目建设的必要性和可行性分析

1、项目建设的必要性分析

（1）顺应国家产业战略，预留高端产能载体，支撑产业链长期自主可控

集成电路产业是国民经济的战略性支柱产业，保障产业链供应链自主可控是国家重要战略部署。当前，高端蚀刻引线框架领域仍存在供给短板，高精度、车规级产品部分依赖进口，产业链自主可控需求十分迫切。

本次蚀刻引线框架生产车间扩建是公司布局中高端蚀刻引线框架产能的核心载体工程。通过新建专业化、高标准的洁净生产厂房，提前完成产业空间布局与公用配套预留，可为后续高端蚀刻引线框架生产线落地提供标准化、合规化的物理载体，避免产能扩张时重复开展土建工程、大幅缩短扩产周期，为下一次扩产实现蚀刻引线框架产能提升打下坚实基础，长期助力集成电路封装环节自主可控，完全符合国家产业发展战略要求。

（2）破解现有空间瓶颈，快速补齐 eSIM 产能短板，提升公司市场份额

随着下游需求持续增长，公司现有蚀刻引线框架生产场地已饱和，空间瓶颈制约产能进一步扩张；物联网 eSIM 封测业务现有设备产能利用率已处于高位，设备产能短板凸显。

本项目通过新建蚀刻引线框架专用生产车间破解空间约束，为后续产能升级预留充足载体，支撑公司长期产业布局；通过购置 21 台 eSIM 封测先进生产设备，直接形成 1 亿颗/年封测产能，有效缓解当前产能瓶颈，提升产品交付能力，进一步扩大细分市场份额。

（3）优化产品结构，提升公司盈利能力的需要

目前公司传统智能卡业务占比相对较高，高端蚀刻引线框架、物联网 eSIM 封测等高附加值业务仍有扩容空间。通过本次项目建设，公司将快速扩大 eSIM 封测高附加值业务产能规模，提升中高端产品营收占比；同时完成蚀刻引线框架高端产能载体布局，为后续高附加值产品放量奠定基础，优化整体产品结构，提升综合毛利率与盈利水平，增强抗周期波动能力。

（4）完善产业布局，提升公司核心竞争力的需要

项目依托现有厂区公用配套与管理体系，蚀刻引线框架生产车间扩建子项目仅新建专业化生产车间，物联网 eSIM 芯片封测扩产子项目仅购置核心工艺设备，可进一步深化“引线框架材料+封装测试服务”的一体化协同优势，降低综合运营成本，提升定制化服务能力；同时配套升级数字化生产管控系统，推动生产过程精细化管控，全面夯实公司核心竞争力。

（5）推动地方产业升级，助力区域经济高质量发展的需要

项目属于高端电子信息制造范畴，技术含量高、产业带动性强，建成后将壮大淄博市半导体产业规模，吸引上下游配套企业集聚，完善区域产业链条，同时带动当地就业、增加地方财政税收，推动区域产业升级与经济高质量发展。

2、项目建设的可行性分析

（1）各级政策全面支持，发展环境优良

本项目属于国家鼓励发展的集成电路产业范畴，符合国家、省、市三级产业政策导向，可享受设备购置补贴、研发费用加计扣除、增值税加计抵减等多项政策红利，政策支撑体系完善，发展环境优良。

（2）市场需求持续旺盛，客户资源稳定可靠

高端蚀刻引线框架、eSIM 封测市场增速显著高于行业平均水平，行业整体空间广阔。公司深耕行业多年，与国内外多家知名集成电路设计、封装企业建立了长期稳定合作关系，客户资质优良、合作稳固。项目新增产能可通过深挖现有客户需求、拓展行业新客户有效消化，市场风险整体可控。

（3）技术积累深厚扎实，工艺方案成熟可靠

公司在蚀刻引线框架与 eSIM 封测领域拥有多年量产经验，掌握精密光刻、高精度蚀刻、高可靠封装测试等核心技术。本项目 eSIM 扩产采用的工艺路线均为已通过量产验证的成熟方案，设备选型为行业主流先进设备，研发与技术团队稳定，可保障项目工艺调试、技术优化与产品迭代需求；蚀刻引线框架车间建设

标准匹配公司现有成熟工艺技术要求，后续产线落地具备充分技术支撑，整体技术方案风险可控。

（4）财务状况稳健良好，资金保障能力较强

截至 2025 年末，公司总资产 21.13 亿元，资产负债率仅 8.51%，财务结构十分稳健，经营现金流充裕。本项目总投资 13,000 万元，使用首次公开发行股票部分超募资金 8,781.65 万元，使用公司自有资金 4,218.35 万元，资金筹措方案明确，保障能力强，资金风险可控。

（5）管理团队经验丰富，人才储备充足

公司管理团队拥有多年半导体行业从业经验，具备丰富的企业运营与大型项目管理经验；拥有覆盖研发、生产、质量、销售全环节的专业人才队伍，核心人员稳定。项目所在地周边院校可提供充足的产业工人储备，可通过内部调配与外部招聘快速组建运营团队，保障项目投产需求。

（6）区位条件优越，现有配套完善

蚀刻引线框架生产车间扩建子项目仅需将公用配套管线接入新建厂房；物联网 eSIM 芯片封测扩产子项目仅需新增设备接入现有厂房配套系统，均无需大规模新建站房与管网，可大幅缩短建设周期、降低投资成本；产业配套方面，区域内上下游企业集聚，采购与物流成本低。整体选址合理，外部配套成熟，建设实施条件充分，同时预留的配电、管线接口可直接支撑后续蚀刻产线快速落地。

3、可行性和必要性分析结论

本项目是在公司生产规模不断扩大的基础上，为保证公司生产经营的顺利进行，结合国家产业政策和行业发展特点进行的新项目投资建设。本项目的实施将改善生产环境，提升产线自动化、智能化水平，打造高端蚀刻引线框架产能储备载体，为后续实现高密度蚀刻引线框架产能提升打下坚实基础；同时通过购置物联网 eSIM 芯片封测先进生产检测设备，打通产能瓶颈，扩大 eSIM 芯片封测产能规模，进一步巩固公司在集成电路封装材料与封测细分领域的市场地位，增强企业核心竞争力与持续盈利能力。

本项目的实施建设符合国家产业政策与区域发展规划，市场需求明确，技术方案可行，建设条件具备，财务效益良好，整体风险可控，因此项目建设具备充分的必要性与可行性。

（四）新项目实施面临的主要风险及应对措施

1、市场需求及产业链供应链

半导体行业具备强周期性特征，若下游消费电子、汽车电子、物联网领域需求不及预期，或行业新增产能集中释放导致市场竞争加剧，可能引发 eSIM 封测服务价格下滑、订单量不足，导致项目新增产能利用率偏低，收益不达预期；长期来看，若后续蚀刻引线框架市场需求发生变化，可能影响车间载体的投产节奏与效益释放。公司巩固与现有核心客户的长期战略合作，同步拓展车规级、工业级客户群体，重点布局新能源汽车、工业控制、人工智能等高增长赛道，根据市场行情灵活安排后续产线落地节奏，平滑行业周期影响。持续提升高可靠 eSIM 封测的产品占比，以技术优势构建差异化竞争力，提前布局高端蚀刻引线框架技术储备，为后续产线落地打造差异化竞争优势。

eSIM 封测所需键合金丝等大宗商品价格受国际宏观形势、地缘政治影响波动较大，直接挤压产品毛利；本次采购的高端封测设备若贸易环境变化或厂商产能受限，可能出现交付延迟，影响项目建设进度；后续蚀刻产线所需高精铜带、高端蚀刻设备等存在供应不确定性。公司延续成熟的套期保值机制，结合年度采购计划规范开展铜、黄金等大宗商品期货套期保值，锁定核心原材料采购成本；建立价格监测预警机制，低位适度增加备货，高位控制库存。针对核心原材料、核心设备培育 2-3 家合格备选供应商，降低单一供应商依赖；持续推进高端设备、关键物料的国产替代验证，逐步提升国产化采购比例。

2、关键技术与运营管理

若半导体封装技术路线快速迭代，公司现有技术储备未能及时跟进，可能导致产品竞争力下降，同时影响后续蚀刻产线的技术路线选择；核心技术若存在专利侵权纠纷或人员流失导致技术泄密，将损害企业核心利益。公司聚焦高密度蚀刻工艺、车规级封测可靠性、先进封装配套材料等方向开展技术攻关，提前布局下一代产品技术，缩短技术迭代响应周期。完善核心技术专利布局，对关键工艺、产品结构申请发明专利；建立技术保密机制，与核心技术人员签订竞业限制与保密协议；定期开展专利风险排查，规避侵权纠纷。

产能扩张后，生产规模与人员规模同步扩大，若管理体系未能同步升级，可能出现生产调度效率下降、质量管控标准执行走样、成本管控失效等问题；同时半导体行业人才竞争激烈，核心技术人员、熟练操作工流失可能影响生产稳定性。公司依托 MES、WMS 系统实现生产全流程数字化管控，优化生产调度、质量追

溯、成本核算效率，降低产能扩张后的管理复杂度。建立具备行业竞争力的薪酬体系与晋升通道，核心技术人员配套股权激励，降低人才流失率。严格执行 ISO9001、IATF16949 质量体系，强化关键工序质量控制点巡检，保持产品良率稳定，杜绝批量质量事故。

3、工程建设

一是工期延误风险，蚀刻引线框架洁净厂房施工标准高，若施工组织不当、建材供应延迟，可能导致车间无法按期建成，影响后续产能布局节奏；eSIM 设备到货滞后也可能推迟产能释放；两套 2400kW 配电工程施工衔接不畅也可能影响整体进度。二是投资超支风险，建材价格上涨、设计变更、施工质量返工等可能推高建设成本。三是施工安全风险，高处作业、动火作业、临时用电不规范可能引发安全事故。四是工程质量风险，洁净车间密封性、洁净度不达标将直接影响后续生产工艺条件。

公司通过招标选择具备半导体洁净厂房施工资质的承建单位与监理单位，签订固定总价+调价条款的施工合同；制定详细的关键节点进度计划，明确蚀刻车间土建、配电工程、eSIM 设备安装的衔接节点，建立周进度复盘机制，滞后节点及时纠偏；严格管控设计变更，所有变更履行技术、造价双审核。落实工程质量“三检制”，对洁净车间装修、配电工程、工艺管线安装等关键工序实施旁站监理；严格执行施工安全规范，重点管控动火作业、高处作业、临时用电，配备专职安全员全程巡查，杜绝安全事故。提前与设备供应商锁定交付周期，安排专人跟进设备生产、运输进度，在土建施工收尾阶段提前启动设备进场准备，实现土建完工、配电配套与设备安装无缝衔接。

4、投融资与财务效益风险

项目总投资 13,000.00 万元，拟使用首次公开发行股票部分超募资金 8,781.65 万元，使用公司自有资金 4,218.35 万元，若公司经营现金流出现阶段性波动，可能导致项目建设资金拨付不及时，影响施工进度；若未来拓展融资渠道，市场利率上行将推高融资成本。若产品价格下降、成本上升双向挤压，可能导致项目毛利率低于预期；下游客户经营波动可能引发回款延迟、坏账损失；公司存在境外销售业务，人民币汇率大幅波动将产生汇兑损失，侵蚀项目收益。

公司将采取的应对措施：

资金统筹管理：将项目资金纳入公司全面预算管理，按工程进度合理安排资金拨付，提高资金使用效率；预留充足的流动资金缓冲，保障建设与运营资金链安全。

成本与回款管控：推行目标成本管理，分解成本管控指标到各车间、各工序；加强应收账款管理，优化客户信用评级，加大逾期账款催收力度，控制坏账风险。

汇率风险对冲：合理运用远期结售汇、外汇掉期等金融工具，锁定外销业务汇率水平；扩大跨境人民币结算比例，缩小汇率波动敞口。

四、本次使用超募资金投资建设新项目对公司的影响

本次使用部分超募资金投资建设新项目是结合市场环境变化、行业发展趋势及自身发展需求所做出的谨慎、合理决策，符合公司整体发展战略，符合公司业务发展方向。通过本项目的建设实施可建成专业化蚀刻引线框架生产车间及配套公用工程体系，改善生产环境，为后续提升高密度蚀刻引线框架产能以及产线自动化、智能化水平打下坚实基础；同时通过购置物联网 eSIM 芯片封测先进生产检测设备，打通产能瓶颈，扩大 eSIM 芯片封测产能规模，增强公司的核心竞争力及综合实力，促进公司的可持续发展。

本次使用超募资金投资建设新项目有利于提高募集资金的使用效率，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在影响公司及全体股东利益的情形。公司将积极加强对本项目建设内容和进度的监督管理，从而提高募集资金的使用效益。

五、相关审议程序及意见

1、董事会审议情况

公司于 2026 年 8 月 10 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资建设新项目的议案》，公司本次使用部分超募资金投资建设新项目的事项综合考虑了公司发展需求和规划、项目实施的可行性等因素，同意公司使用部分首次公开发行股票超募资金合计 8,781.65 万元及公司自有资金 4,218.35 万元（具体金额以实际建设的金额为准）投资建设蚀刻引线框架生产车间扩建及物联网 eSIM 芯片封测扩产项目。本次超募资金的使用计划符合法律法规、规范性文件等有关规定，未与现有募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展战略和规划，符合公司和全体股东的利益。董事会一致同

意本次使用部分超募资金投资建设新项目的事项，该事项尚需提交公司股东会审议。

2、审计委员会审议情况

公司于 2026 年 8 月 10 日召开第二届董事会审计委员会第十九次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资建设新项目的议案》。审计委员会认为：公司本次使分超募资金投资建设新项目的事项，符合公司发展战略规划，可以提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。本次超募资金的使用计划符合相关法律、法规以及规范性文件和公司《募集资金管理制度》等有关规定，未与现有募集资金投资项目实施计划相抵触，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定。因此，审计委员会一致同意公司本次使用超募资金投资建设新项目的事项。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次使用超募资金投资建设新项目的事项已经公司第二届董事会第二十次会议和第二届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，本事项尚需提交公司股东会审议，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。公司本次使用超募资金投资建设新项目，是结合市场环境变化及公司发展战略所做出的谨慎、合理决策，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上所述，保荐机构对公司本次使用超募资金投资建设新项目的事项无异议。

七、备查文件

1、第二届董事会第二十次会议决议；

2、第二届董事会审计委员会第十九次会议决议；

3、方正证券承销保荐有限责任公司关于新恒汇电子股份有限公司使用超募资金投资建设新项目的核查意见。

特此公告。

新恒汇电子股份有限公司

董事会

2026年8月11日